

## 立即发布

### 投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

### 媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-Tencor™ 宣布推出 eDR™-7000 电子束晶圆缺陷复查系统

*其更高的灵敏度与检测产能使得查找 20 纳米及以下节点之缺陷的速度大大提高*

【加州 MILPITAS 2011 年 7 月 11 日讯】今天，[KLA-Tencor Corporation™ \(NASDAQ: KLAC\)](#) 宣布推出一款用于 20 纳米及以下节点之芯片制造的关键使能工具——eDR™-7000 电子束晶圆缺陷复查系统。eDR-7000 通过突破性技术实现了业界领先的灵敏度与检测产能，解决了当今最前沿的缺陷成像与分类难题，此类对成品率具有致命影响的缺陷可能小至 10 纳米，或位于很深的沟槽或孔洞底部。eDR-7000 是同类工具中唯一能够可靠地识别小至 20 纳米节点晶圆缺陷检测系统之灵敏度阈值的一款工具。其中包括上月推出的 Surfscan® SP3 以及 KLA-Tencor 即将推出的图形晶圆检测产品系列的各个型号。

KLA-Tencor 电子束技术部副总裁兼总经理 Cecelia Campochiaro 博士表示，“eDR-7000 能够让我们全面了解晶圆上的缺陷数量与种类。这款新工具能够将目前可用的复查系统通常会遗漏掉的 10 纳米缺陷及缺陷类型重新定位并予以成像。它每秒钟能够复查多个缺陷——这主要是因为其能够以很高的放大倍率直接找到缺陷部位，省却了先以较低的放大倍率找到缺陷，然后再通过放大得到清晰的影像这一非常耗时的中间步骤。eDR-7000 所提供的数据在数量和质量上都非常出色，让工程师们能够基于缺陷数量与种类的准确再现来采取适当的纠正措施。”

与当前一代的 eDR-5210 平台相比，eDR-7000 增加了以下新的功能特点与改进：

- 第三代经过生产线检验的电子束湿浸柱，可提高分辨率和改善外形成像质量；
- 先进的平台与振动隔离系统，可使坐标精度提高三倍，缺陷复查速度提高达四倍；

- 大幅提高的裸晶圆缺陷检测灵敏度，包括对能量色散 X 射线 (EDX) 成分分析进行的改进；
- 独特的光罩缺陷复查模式，可快速检查晶圆上可能有光罩缺陷的部位；
- 工艺窗口特测定的产能显著提高；
- 电压差成像模式，可用于复查电子束晶圆检测数据；
- 离线缺陷分类功能，可提高该工具在成像工作方面的可用性。

目前已经接到领先的存储器、逻辑晶圆、晶圆代工工厂及设备制造商们订购 eDR-7000 系统的数份订单。另有多套系统已经在先进的开发与生产线中投入使用。为了保持高性能和高产能，eDR-7000设备由 [KLA-Tencor 的全球综合服务网络](#) 提供支持。关于 KLA-Tencor 电子束复查系统的更多信息，请访问产品网页：<http://www.kla-tencor.com/defect-review/edr-7000-series.html>。

#### 关于 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司（纳斯达克股票代码：KLAC）是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商，它与全球客户合作，开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、数据存储、LED、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队，三十年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州 Milpitas，并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息，请访问网站 [www.kla-tencor.com](http://www.kla-tencor.com)。(KLAC-P)

#### 前瞻性声明：

本新闻稿中除历史事实以外的声明，例如关于 eDR-7000 的预期性能，半导体产业的趋势（及其带来的预期挑战），KLA-Tencor 的客户对 eDR-7000 的预期使用，KLA-Tencor 预期可能推出的新检测系统，以及 eDR-7000 工具使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述，均为前瞻性声明，并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期，且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素，包括延迟采用新技术（无论是由于成本或性能问题抑或其他问题），其他公司推出竞争性产品，或影响 KLA-Tencor 产

品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制，因此实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###